PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-323897

(43)Date of publication of application: 24.11.2000

(51)Int.CI.

H05K 13/04

(21)Application number: 11-129339

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

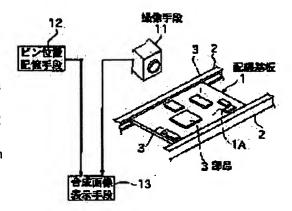
11.05.1999

(72)Inventor: MURAKAMI NORIYASU

(54) EQUIPMENT FOR POSITIONING SUPPORT PIN FOR WIRING BOARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To shorten the time required for positioning support pins and make a correct positioning of them, by superposing the photographed rear face data of a wiring board mounted with components and the support ping layout positions data corresponding to the rear face of the wiring board, and then displaying the synthesized image. SOLUTION: An image pickup means 11 photographs a face 1A of a wiring board which is a rear face and then processes the data about the substrate image to output it to a composite image display 13. A pin position storage means 12 stores the positions of the pins for supporting the rear face 1A from downwards when mounting specified components on the other face of the wiring board 1, and outputs the data to the composite image display 13 as the data about the arrangement positions of the supports pins. The composite image display 13 superposes the substrate image obtained from the image pickup means 11 and the data about the arrangement positions stored in the pin position storage means 12 and display the composite image.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

This Page Blank (uspto)

(19)日本国特許/广〈J P〉

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公園番号 **特開2000-323897** (P2000-323897A)

(43)公開日 平成12年11月24日(2000.11.24)

(51) Int.CL'

政別配身

FI

チャンド(参考)

HO & K 18/04

HO 5 K 18/04

Q 5ES18

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

(21)出職爭号

特顯平11~129339

(22) 出贈日

平成11年6月11日(1999.5.11)

(71) 出職人 000002185

ソニー株式会社

東京都基川区北基川8丁目7番35号

(72)発明者 村上 範郡

愛知県福田郡幸田町大学収略字巻を入1番

地 ソニー幸田株式会社内

Fターム(参考) 52213 AA01 AA11 AB02 CC04 CC09

DD02 DD05 DD12 DO50 EE02

HE05 FF25 FF29 FF40

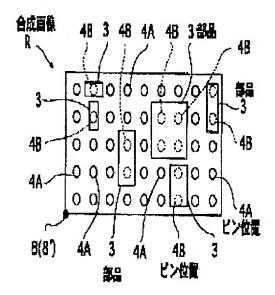
(54) 【発明の名称】 配験基板用下受けピンの位置決め装置

(57)【要約】

【課題】 下受けピンの位置決め作業時間を従来よりも 短縮しながら、下受けピンの正確な位置決め作業を行う ことができる配線基板用下受けピンの位置決め装置を提 供すること。

【解決手段】 部品3を搭載した配線基板1の裏面1A の撮像手段11による画像データと、予め下受けピン4 の位置が決定されている配設位置データとを合成画像表 示手段13にで合成した合成画像Rに基づいて、下受け ピン4と部品3とが重なる位置4Bを容易に判断するこ

とができる.



【特許請求の範囲】

【請求項1】 裏面に部品を搭載した配線基板を下方から支持する下受けピンの設定位置を決定する配線基板用下受けピンの位置決め装置において、

部品を搭載した前記配線基版の裏面を撮影する撮像手段 と

前記下受けビンの前記配線基板の裏面に対応する配設位 置データを記憶するビン位置記憶手段と、

対記録像手段により得られた画像データと前記配設位置 データとを相重ね合わせ、その合成画像を表示する合成 画像表示手段とを備えたことを特徴とする配線基板用下 受けピンの位置決め装置。

【請求項2】 前記画像データと前記配設位置データとの重ね合わせは、前記画像データ上の一点と、これに対応する位置に設けられた前記配設位置データ上の一点とを合致させることにより行われることを特徴とする請求項1に記載の配線基板用下受けビンの位置決め装置。

【請求項3】 前記操像手段は、前記配線基板の上方に 配置され、

前記表面側の配線基板上へ部品が搭載された状態の画像 データが前記合成画像表示手段に供給されることを特徴 とする語求項1に記載の配線基板用下受けピンの位置決 の結番。

【請求項4】 前記画像データは、前記配線基板の裏面を複数回に分けて前記機像手段により撮影した各データを合成して得られることを特徴とする請求項1に記載の配線基板用下受けビンの位置決め装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板両面実装時に おける下受けピン(バックアップピン)の設定位置を決 定する、配線基板用下受けピンの位置決め装置に関す る。

[0002]

【従来の技術】近年では、製品の小型化、高機能化に伴って、配線基板の両面に部品を実装する両面実装が一般的となりつつある。配線基板上の導体パターンへの部品の実装は、配線基板を水平に保持した状態で上方に位置する面から実装が行われる。このとき、配線基板の自重による数ミリの反りを矯正するために、一般に配線基板の下方の面に対応してマトリックス状に配置された複数の下分の面に対応してマトリックス状に配置された複数の下分の面に対応して、配線基板の下方の面を支持する。

【0003】例えば図7Aに示すように、配線基板1の上方の面1Aへ所定の部品3を搭載するとき、下受けピン4により配線基板1の他方の面1Bを上方へ突き上げ、これら下受けピン4と配線基板1の搬送をガイドする搬送レール2との間で配線基板1を水平に保持する。下受けピン4は、支持板5の孔5aに基脱可能に配置され、支持板5の上下移動により下受けピン4が一体となって配線基板1の下面を支持する上昇位置と、配線基板

1の下面から遠ざかる下方位置をとる。

【0004】ところが、図7日に示すように、所定の部品3を搭載した一方の面1Aを下方にして今度は他方の面1Bに所定の部品3を搭載するときは、部品3の搭載場所によっては部品3と下受けピン4とが当たることになるので、当該下受けピン4を支持板5から外す必要がある。

【0005】このように図7日において配線基板1の裏面に相当する下方の面1Aに部品3が搭載されているとき、この配線基板1の裏面1Aを下方から支持する下受けピン4の位置決め作業を、従来では、作業者が実際に部品が搭載された基板を見ながら行っており、また、位置決め後に実際に基板を部品実装装置へ供給して下受けピン4の設定位置の確認を何度も行っていた。したがって、下受けピン4の位置決め作業に多くの時間を要するとともに誤った位置に下受けピン4が配置されることもあり、正確な位置決め作業を行うことができないという問題がある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上述の問題に 鑑みてなされ、下受けピンの位置決め作業時間を従来よ りも短縮しながら、下受けピンの正確な位置決め作業を 行うことができる配線基板用下受けピンの位置決め装置 を提供することを課題とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】以上の課題を解決するにあたり、本発明に係る下受けピンの位置決め装置は、部品を搭載した配線基板の裏面を操影する始像手段と、下受けピンの配線基板裏面に対応する配設位置データを記憶するピン位置記憶等及と、境像手段により得られた画像データと上記配設位置データとを相重れ合わせ、その合成画像を表示する合成画像表示手段とを備えている。 【0008】すなわち、部品を搭載した配線基板裏面の始像手段による画像データと、子め下受けピンの位置が決定されている配設位置データとを、合成画像表示手段にて合成し表示することにより、作業者は下受けピンの位置と部品位置とを1つの画像で同時に確認することができ、よって、部品が存在しない位置への下受けピンの設定又は差し替えを従来より短時間にかつ正確に行うこ

とが可能となる。 【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

【0010】図1を参照して、配線基板1は部品が搭載される面を上向きにして搬送レール2に沿って部品搭載位置へ搬送され、搬送レール2に設けられたストッパフに配線基板1が当接することにより位置決め停止される。

【OO11】図2を参照して、本実施の形態における下受けピン位置決め装置は、操像手段11、ピン位置記憶

手段12および合成画像表示手段13を備えている。部品搭載位置で停止した配線基板1の斜の上方には、例えばCCDカメラで成る路像手段11が配置され、所定の部品3を搭載した、後に裏面となる配線基板1の面1Aを撮影し、図3に示すような基板画像Pをデータ処理して合成画像表示手段13に出力する。

【0012】-方、ビン位置記憶手段12は、図4に示すように、配線基板1の他方の面に所定の部品を実装する際にその表面1Aを下方から支持する下受けビン4のピン位置4Aを記憶しており、これを配設位置データとして合成画像表示手段13に出力する。

【0013】合成画像表示手段13は、規像手段11により得られた図3に示す基板画像Pと、ピン位置記憶手段12により記憶された配設位置データに基づいて得られる図4に示すピン配設位置画像Qとを相重れ合わせ、図5に示すような合成画像Rを表示する。この図において、部品3とピン配設位置4Aとが重なる部分4Bは破線で示しているが、点滅表示させるようにして作業者に注意を促すようにしてもよい。また、ピン配設位置画像Qと実際のピン位置に相関連する番号などを付けて置くことで、部品のない位置に下受けピン4を設定することが容易に行うことができる。

【0014】以上の構成により、合成画像Rから下受け ピン4の配置すべき位置を正確に判断することができる ので、下受けピン4の位置決め作業を従来より短時間で 行うことができるとともに、下受けピン4の位置決めの 誤りなどによる部品損失をなくすことができる。

【0015】なお、下受けピン4の位置決めを行った後の、実際の下受けピン4の配置替えは、作業者が手作業で行うだけでなく、例えば特開平5-335800号公報に記載の下受けピン設定装置を用いて自動的に行うようにしてもよい。

【0016】また、基板画像Pとピン配設位置画像Qとの合成は、例えば配線基板1の位置決め用として設けられたストッパ7(図1参照)と当接する配線基板1上の点8を原点と、この原点8に対応する位置に設けたピン配設位置画像Q上の点8'とを合致させることにより、確実な画像合成作用が得られる。

【0017】また、配線基板1の種類の変更によりその大きさが変化する場合は、操像手段11の解像度(ピクセルレート)から取り込まれた画像の大きさを知ることができるので、それに合わせてピン配設位置画像Qを拡大、縮小すればよい。

【0018】さらに、操像手段11により基板画像Pを 一度に取り込めない場合には、図6に示すように配線基 板1を複数の領域15A、15B、15C及び15Dに分割して、各領域ことに取り込んだ画像データを後で合成し、一枚の基板画像を得るようにすればよい。画像データの合成については、婚像手段11の解像度、移動量などに基づいて行うことができる。

【0019】以上、本発明の実施の形態について説明したが、勿論、本発明はこれに限定されることなく、本発明の技術的思想に基づいて種々の変形が可能である。

【0020】例えば以上の実施の形態では、操像手段11を配線基板1の上方位置に配置したが、これに代えて、配線基板1の下方位置に配置してもよい。この場合、配線基板1の裏面1Aに所定の部品が搭載された後、反転され、下方を向いた状態で撮影されることになる。

[0021]

【発明の効果】以上述べたように、本発明の配線基板用下受けピンの位置決め装置によれば、下受けピンの位置と部品位置とを1つの画像で同時に確認することができ、よって、部品が存在しない位置への下受けピンの設定又は差し替えを従来より短時間にかつ正確に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】部品搭載位置へ配線基板が搬送される様子を示す平面図である。

【図2】本発明の実施の形態による配線基板用下受けビンの位置決め装置の装置概要を説明する図である。

【図3】本発明に係る嫌像手段により撮影した配線基板 裏面の画像の模式図である。

【図4】 本発明に係るピン位置記憶手段が記憶する下受けピンの配設位置画像の模式図である。

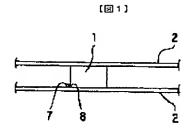
【図5】 基板画像と下受けピンの配設位置画像との合成画像の模式図である。

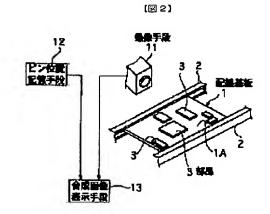
【図5】操像手段による配袋基板の裏面の操影を複数回に分けて行い、その後合成する実施態機を説明する配線 基板裏面の模式図である。

【図7】下受けピンの作用を説明する要部の正面図であり、Aは一方の面に所定の部品を実装するときの様子を示し、Bは他方の面に所定の部品を実装するときの様子を示している。

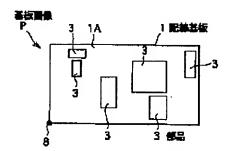
[符号の説明]

1 …配線基板、1 A…裏面、2…搬送レール、3…部品、4…下受けビン、7…ストッパ、8…原点、11… 撮像手段、12…ビン位置記憶手段、13…合成画像表示手段、P…基板画像、Q…ビン配設位置画像、R…合成画像。

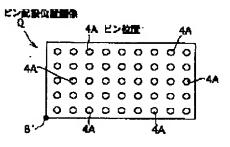




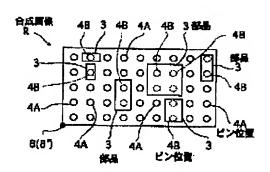


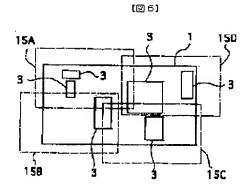


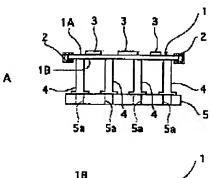
[24]

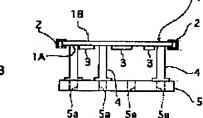


[図5]









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.